

●USP-2B01 パッケージ許容損失

USP-2B01 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：基板 114.3mm×76.2mm に対して

銅箔面積 裏面 74.2mm×74.2mm

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚 : 1.6mm

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装($T_{jmax}=125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗(°C/W)
25	100	1000.00
85	40	

